

様式第二十一（第13条関係）

事業再編計画の内容の公表

1. 認定をした年月日
令和2年4月20日

2. 認定をした事業者名
昭和電工株式会社

3. 事業再編の目標

(1) 事業再編に係る事業の目標

昭和電工株式会社（以下「昭和電工」という。）は、「社会的に有用かつ安全でお客様の期待に応える製品・サービスの提供により企業価値を高め、株主にご満足いただくと共に、国際社会の一員としての責任を果たし、その健全な発展に貢献すること」を経営理念に、非有機・無機化学品事業を中心とした個性派事業群の確立に取り組んでいる。

一方、日立化成株式会社（以下「日立化成」という。）は、「時代を拓く優れた技術と製品の開発を通して社会に貢献すること」を企業理念とし、今後も成長が見込まれ、日立化成の技術的な強みが発揮できる4つの注力事業領域（情報通信、モビリティ、エネルギー、ライフサイエンス）において、顧客への最適なソリューションの提供を推進している。

近年の素材産業は、GAFAをはじめとするテクノロジー企業の存在感が増しており、これらテクノロジー企業が、部材・素材レベルの技術要件や生産技術への要求特性の実現に向け直接的な関与を深め、素材メーカー等へ直接アクセスを図る構図となっている。また、中国の素材メーカーが母国市場の大きさを背景として、規模の経済性を活かした事業を展開し、中東の素材メーカーも川上の資源調達からの一貫したバリューチェーンを構築することによりコスト競争力を高めている。世界市場での競争力を高める動きが加速するなか、今後、我が国の素材メーカーがグローバルトップとして勝ち残るためには「適正な市場規模においてトップシェアを有するグローバルリーダーとして事業成長を加速させる」こと、そして、多様化かつ高度化する顧客ニーズに柔軟に応えるために「幅広い素材や技術を組み合わせたソリューション提供」が重要と考えている。

このような事業環境の下、昭和電工と日立化成は、両社それぞれの強みを持ち寄り、経営資源を結集することにより、幅広い素材を取り扱い、素材から設計・評価までを一貫して内部で実現可能な能力を備えることを目的として、昭和電工が出資するHCホールディングス株式会社（以下「HCホールディングス」という。）を通じて、日立化成の全株式を取得（以下「本件株式取得」という。）することを予定している。

本件株式取得を契機に、情報通信事業、モビリティ事業等の競争力強化を図るとともに、今後高い成長が見込まれるライフサイエンス事業においては、R&Dの融合等により、環境変化に対応する強固な事業ポートフォリオ構築を目指す。

この目標の実現にあたり、ステアリング・コミッティーの設立・運営により、事業再編計画の進捗状況を適時適切にモニタリングできる体制構築に努める。

以上の方策により、昭和電工及び日立化成の経営資源の最適配置によって、生産性の向上及び付加価値創出を図り、企業価値の更なる向上を目指す。

(2) 生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標

計画の対象となる事業の生産性向上としては、2022年度には2019年度に比べて、有形固定資産回転率を5.0%以上向上させることを目標とする。

財務内容の健全性の向上としては、2022年度において当社の有利子負債はキャッシュフローの2.0倍、経常収支比率は118.2%となる予定である。

2. 事業再編の内容

(1) 事業再編に係る事業の内容

①計画の対象となる事業

高機能材料分野

〈選定の理由〉

近年の素材産業は、GAF Aをはじめとするテクノロジー企業の存在感が増しており、これらテクノロジー企業が、部材・素材レベルの技術要件や生産技術への要求特性の実現に向け直接的な関与を深め、素材メーカー等へ直接アクセスを図る構図となっている。また、中国の素材メーカーが母国市場の大きさを背景として、規模の経済性を活かした事業を展開し、中東の素材メーカーも川上の資源調達からの一貫したバリューチェーンを構築することによりコスト競争力を高めている。

昭和電工は幅広い素材に対する素材設計技術・素材解析技術や、異素材接着技術を強みとする。計画の対象となる高機能材料分野を含む個性派事業は、昭和電工の売上の3分の1以上を占めている。

一方で、日立化成は、素材特性を生かした材料設計から、機能評価、モジュール部品化を含むプロセス技術に至る機能設計力を強みとし、計画の対象となる高機能材料分野は、日立化成の売上の4割以上を占めている。

今後は、昭和電工と日立化成が一体となることにより、幅広い素材を取り扱い、素材から設計・評価までを一貫して内部で実現可能な能力を備える、高機能材料分野における「ワンストップ型先端材料パートナー」のポジションを確立することが重要であると考え、当該事業を対象として選定した。

②実施する事業の構造の変更と分野又は方式の変更の内容

HCホールディングスが昭和電工および株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」という。）、株式会社日本政策投資銀行（以下「日本政策投資銀行」という。）から出資を受けたうえで、日立化成の全株式を取得し、昭和電工の幅広い素材に対する素材設計技術・素材解析技術や、異素材接着技術と、日立化成の素材特性を生かした材料設計から、機能評価、モジュール部品化を含むプロセス技術に至る機能設計力を掛け合わせることで、素材から設計・評価までを一貫して内部で実現可能な事業体制構築を目指す。

上記の事業体制構築による生産性の向上は、高機能材料分野における市場構造に照らしても持続的なものと見込まれる。また、当該事業分野は過剰供給構造にない。

・出資の受入れ

HCホールディングスは、昭和電工を引受先とする普通株式の発行及び、みずほ銀行、日本政策投資銀行を引受先とするA種優先株式の発行を実施する。

・他の会社の株式の取得

HCホールディングスが、日立化成の全株式を日立製作所及びその他少数株主より取得する。

(事業の構造の変更)

<普通株式の発行>

- ① 出資者：昭和電工株式会社
- ② 増資額：295,000,000,000 円
- ③ 増加する資本金：147,500,000,000 円
- ④ 増資の方法：株主割当増資
- ⑤ 増資予定日：2020 年 4 月 27 日

<A 種優先株式の発行>

- ① 出資者：株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行
- ② 増資額：275,000,000,000 円
- ③ 増加する資本金：137,500,000,000 円
- ④ 増資の方法：第三者割当増資
- ⑤ 増資予定日：2020 年 4 月 27 日

(事業の分野又は方式の変更)

本件株式取得を通じて、事業効率化やコスト構造改革により、3 年後を目処に年間 200 億円以上のコストシナジー実現を目指す。具体的には、共同購買による調達費削減、製造プロセス・拠点の統廃合による間接費の削減等の施策を実施する予定である。

- (2) 事業再編を行う場所の住所
東京都港区芝大門一丁目 13 番 9 号
昭和電工株式会社

東京都港区芝大門一丁目 13 番 9 号
HC ホールディングス株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号
日立化成株式会社

- (3) 関係事業者・外国関係法人に関する事項
HC ホールディングス株式会社
昭和電工が、議決権の 100%を保有するため、関係事業者に該当する。

日立化成株式会社
HC ホールディングスが、発行済株式総数の 100%を取得する予定であり、関係事業者に該当する。

- (4) 事業再編を実施するための措置の内容
別表 1 のとおり。

3. 事業再編の実施時期

開始時期：2020 年 4 月

終了時期：2022 年 12 月

4. 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法

(1) 必要な資金の額及び調達方法の概要

株式取得資金については、昭和電工から2,950億円、みずほ銀行および日本政投資銀行から2,750億円の出資を受けるとともに、みずほ銀行から最大4,000億円の借入により調達する予定である。

5. 事業再編に伴う労務に関する事項

(1) 事業再編の開始時期の従業員数 (2019年12月末時点)

HCホールディングス	0名
昭和電工	10,476名
日立化成	22,989名

(2) 事業再編の終了時期の従業員数

HCホールディングス	0名
昭和電工	11,139名
日立化成	27,100名

(3) 新規に採用される従業員数

HCホールディングス	0名
昭和電工	660名
日立化成	4,382名

(4) 事業再編に伴い出向または解雇される従業員数

HCホールディングス	なし
昭和電工	なし
日立化成	なし

6. その他

該当なし

別表 1

1. 事業構造の変更、事業の分野又は方式の変更の内容、期待する支援措置

措置事項	実施する措置の内容及びその実施する時期	期待する支援措置
法第2条第11項第1号の内容		
へ 出資の受入れ	<p>HC ホールディングスは昭和電工を引受先とする普通株式及び、みずほ銀行、日本政策投資銀行を引受先とするA種優先株式を発行する</p> <p><普通株式の発行></p> <p>① 出資者：昭和電工株式会社 ② 増資額：295,000,000,000円 ③ 増加する資本金：147,500,000,000円 ④ 増資の方法：株主割当増資 ⑤ 増資予定日：2020年4月27日</p> <p><A種優先株式の発行></p> <p>① 出資者：株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 ② 増資額：275,000,000,000円 ③ 増加する資本金：137,500,000,000円 ④ 増資の方法：第三者割当増資 ⑤ 増資予定日：2020年4月27日</p>	<p>租税特別措置法第80条第1項第1号（資本金の額の増加に伴う登録免許税の税率の軽減）</p>
法第2条第11項第2号の要件		
イ 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成の変化	<p>昭和電工の幅広い素材に対する素材設計技術・素材解析技術や、異素材接着技術と、日立化成の素材特性を生かした材料設計から、機能評価、モジュール部品化を含むプロセス技術に至る機能設計力を掛け合わせることで、素材から設計・評価までを一貫通貫で提供できる体制構築を目指す。</p> <p>具体的には、半導体実装事業やLiB材料等におけるシナジーを想定しており、これらの取り組みにより、当該分野の売上高を、全体売上高の1.1%以上とすることを目標としている。</p>	